



PANEL THERMOCHIP

PANEL THERMOCHIP	e total (mm)	RT (m2K/W)	U (W/m2K)	Peso (kg/m2)	Peso (kg/panel)	*3 apoyos L=1220	
						Carga max. (kg/m2)	Carga a L=200 (kg/m2)
TFH/9-40-19_XPS 40mm	68,00	1,40	0,71	17,18	25,15	915,0	220,00
TFH/9-50-19_XPS 50mm	78,00	1,70	0,59	17,50	25,62	1045,00	260,00
TFH/9-60-19_XPS 60mm	88,00	1,90	0,53	17,82	26,09	1180,00	294,00
TFH/9-80-19_XPS 80mm	108,00	2,47	0,40	18,46	27,03	1340,00	322,00
TFH/9-100-19_XPS 100mm	128,00	2,89	0,35	19,10	27,96	1590,00	400,00
TFH/9-120-19_XPS 120mm	148,00	3,62	0,28	19,74	28,90	1785,00	430,00
TFH/9-140-19_XPS 140mm	168,00	4,19	0,24	20,38	29,84	1944,00	470,00
TFH/9-160-19_XPS 160mm	188,00	4,76	0,21	21,02	30,77	>1944,00	>407,00
TFH/9-200-19_XPS 200mm	228,00	5,59	0,18	22,30	32,65	>1944,00	>407,00

*Resistencia mecánica, cargas positivas en apoyos. L en mm

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Tablero exterior - Aglomerado hidrófugo

Espesor	e (mm)	19
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,13
Densidad	D (kg/m3)	600
Difusión al vapor de agua	μ	20
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1700

Núcleo aislante - XPS

Espesor	e (mm)	40	50	60	80	100	120	140	160	200
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,033	0,033	0,035	0,035	0,037	0,035	0,035	0,035	0,037
Densidad	D (kg/m3)	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Difusión al vapor de agua	μ	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1.450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450

Tablero interior - Tablero fenólico

Espesor	e (mm)	9
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,21
Densidad	D (kg/m3)	550
Difusión al vapor de agua	μ	110
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1600